

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成23年4月21日(2011.4.21)

【公開番号】特開2009-224741(P2009-224741A)

【公開日】平成21年10月1日(2009.10.1)

【年通号数】公開・登録公報2009-039

【出願番号】特願2008-70798(P2008-70798)

【国際特許分類】

H 01 L 23/04 (2006.01)

H 03 H 9/02 (2006.01)

【F I】

H 01 L 23/04 E

H 03 H 9/02 A

【手続補正書】

【提出日】平成23年3月7日(2011.3.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

底面形状が略矩形の絶縁基板と、該絶縁基板の底面に形成された実装電極と、を備えた電子部品用パッケージであって、

前記実装電極は、前記絶縁基板が露出するように当該実装電極を分割させない長さの溝部が形成されたような構成であることを特徴とする電子部品用パッケージ。

【請求項2】

前記溝部の全周が前記実装電極に囲まれていることを特徴とする請求項1に記載の電子部品用パッケージ。

【請求項3】

前記溝部は、前記実装電極の外周から内側の所まで切り欠いた切欠状であることを特徴とする請求項1に記載の電子部品用パッケージ。

【請求項4】

前記実装電極は、前記絶縁基板の2つの対向する底辺に沿って夫々形成されていることを特徴とする請求項1に記載の電子部品用パッケージ。

【請求項5】

前記実装電極は、前記絶縁基板の底面四隅に夫々形成されていることを特徴とする請求項1に記載の電子部品用パッケージ。

【請求項6】

前記実装電極が夫々沿うように形成された前記絶縁基板の2つの対向する底辺と平行で且つ前記実装電極の中心を通る直線によって、前記実装電極を2つの電極領域に分割し、前記絶縁基板の中心側に位置する一方の電極領域の面積をA、他方の電極領域の面積をBとしたときに、 $A > B$ となるような位置に前記溝部を形成したことを特徴とする請求項4に記載の電子部品用パッケージ。

【請求項7】

前記実装電極の頂点のうち、前記絶縁基板の端縁側に位置する2つ頂点同士を結ぶ対角線により前記実装電極を2つの電極領域に分割し、前記絶縁基板の中心側に位置する一方の電極領域の面積をA、他方の電極領域の面積をBとしたときに、 $A > B$ となるような位

置に前記溝部を形成したことを特徴とする請求項5に記載の電子部品用パッケージ。

【請求項8】

前記絶縁基板の前記溝部と対応する位置に凹部を形成したことを特徴とする請求項1乃至7の何れか一項に記載の電子部品用パッケージ。

【請求項9】

請求項1乃至8の何れか一項に記載の電子部品用パッケージを用いて構成したことを特徴とする表面実装型電子デバイス。